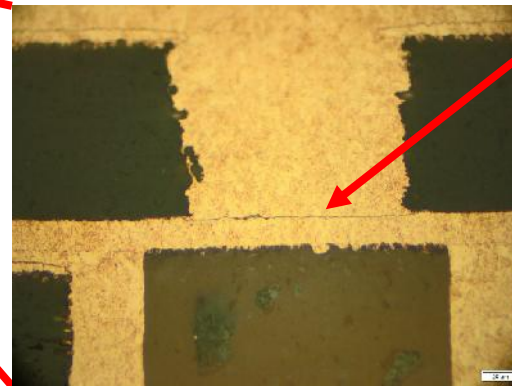
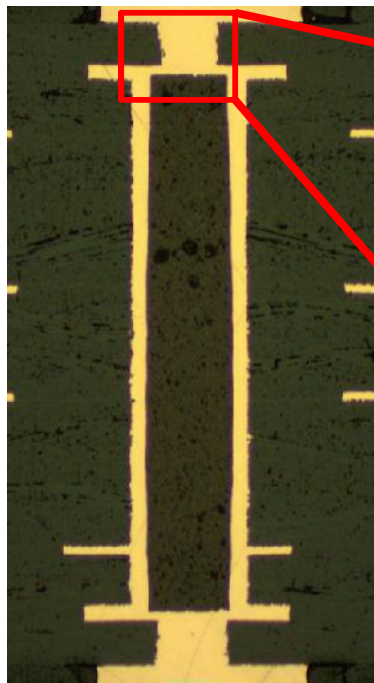


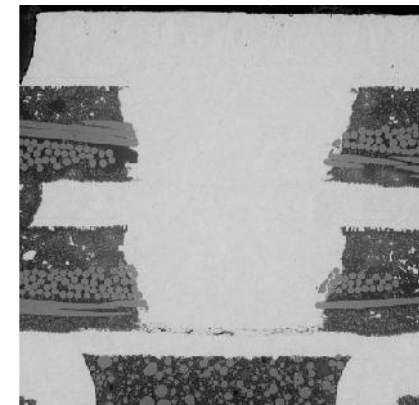
Empfehlungen/Kommentare zu „IPC 2226“ (Umsetzung obliegt Kunden-Lieferanten-Vereinbarung)

Zielstellung:

- **Erhöhung der Zuverlässigkeit von elektronischen Komponenten**
Reduzierung des Fehlerrisikos einer Separation der Kupferschichten durch thermische Belastung im Lötprozess.



**Separation nach
thermischer Belastung**



Quelle: Bill Birch,
PWB Interconnect Solutions Inc.

Empfehlungen/Kommentare zu „IPC 2226“ (Umsetzung obliegt Kunden-Lieferanten-Vereinbarung)

Auszug aus IPC 2226:

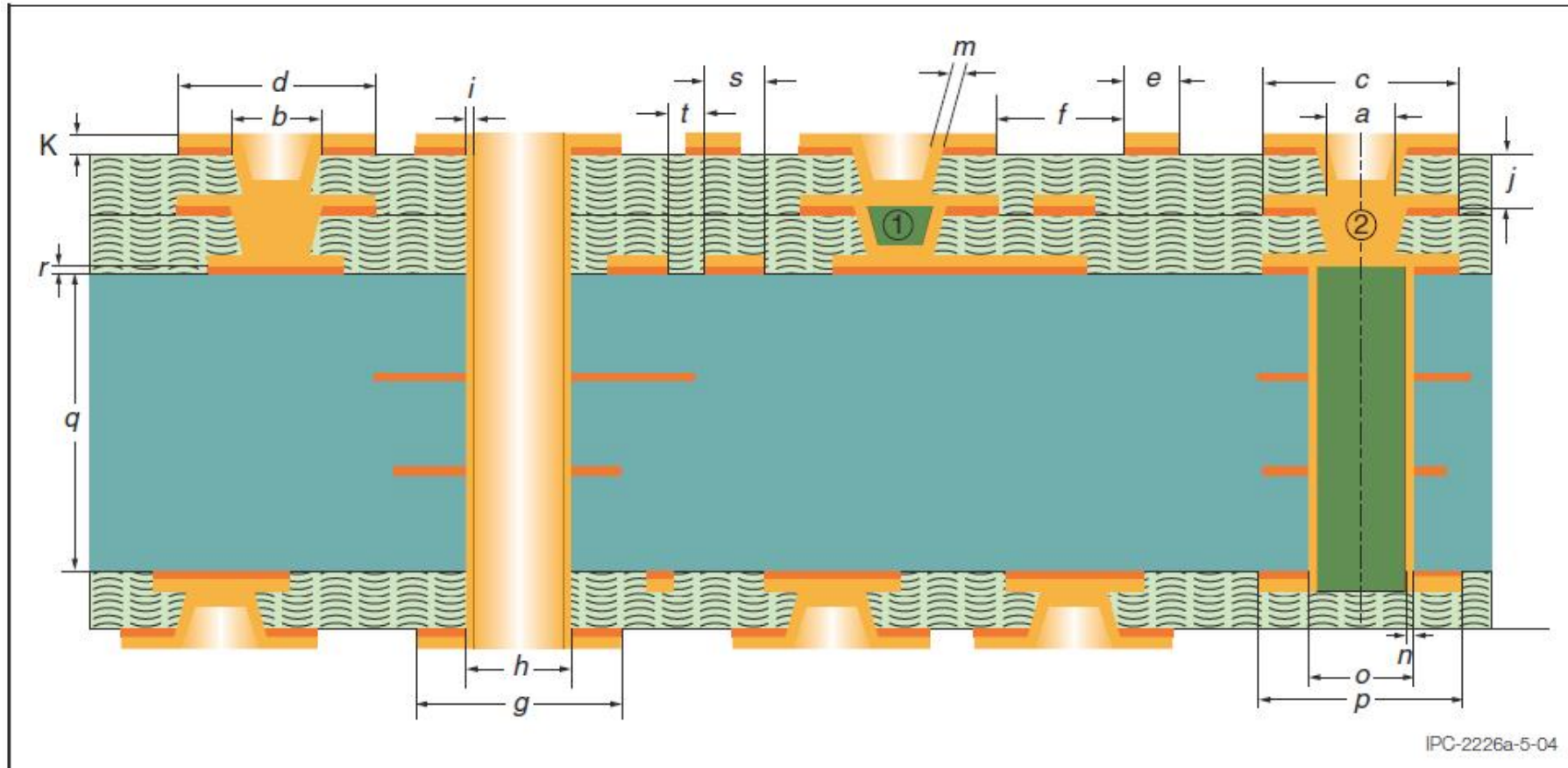


Abbildung 5-4 Typ III HDI-Konstruktion mit gestapelten Microvias

(Achtung: Unsymmetrische Konstruktionen wie oben gezeigt können zu übermäßiger Wölbung und Verwindung führen.)

Hinweis 1: Stapelung nicht empfohlen für Harz oder leitfähige/nicht leitfähige gefüllte Microvias.

Hinweis 2: Das Stapeln über Harz oder leitfähigen/nicht leitfähigen gefüllten Durchkontaktierungen wird nicht empfohlen, da die Zuverlässigkeit beeinträchtigt werden kann. Die Verwendung von versetzten Strukturen wird stattdessen empfohlen.

Vorsicht: HDI-Design mit Microvias, die auf vergrabenen harzgefüllten Vias gestapelt sind, wird nicht empfohlen.

Empfehlungen/Kommentare zu „IPC 2226“ (Umsetzung obliegt Kunden-Lieferanten-Vereinbarung)

Empfehlung zur Umsetzung der IPC 2226:

Ausführung der Microvias versetzt gestapelt zu den harzgefüllten vergrabenen Vias.

Anmerkung:

Der Kupferdeckel der harzgefüllten
Vias kann ggf. entfallen.

